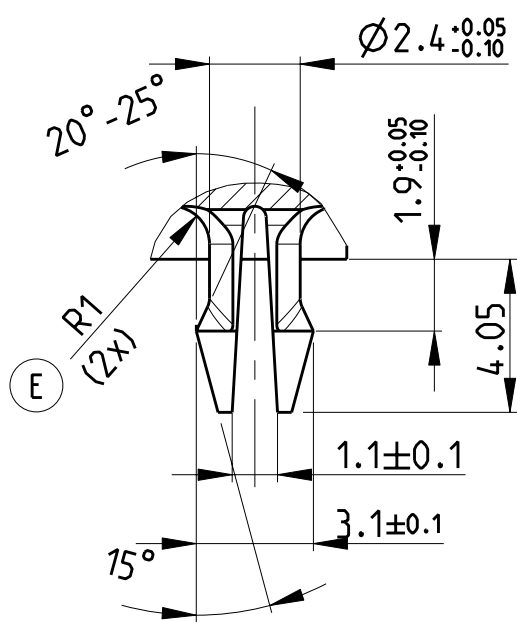
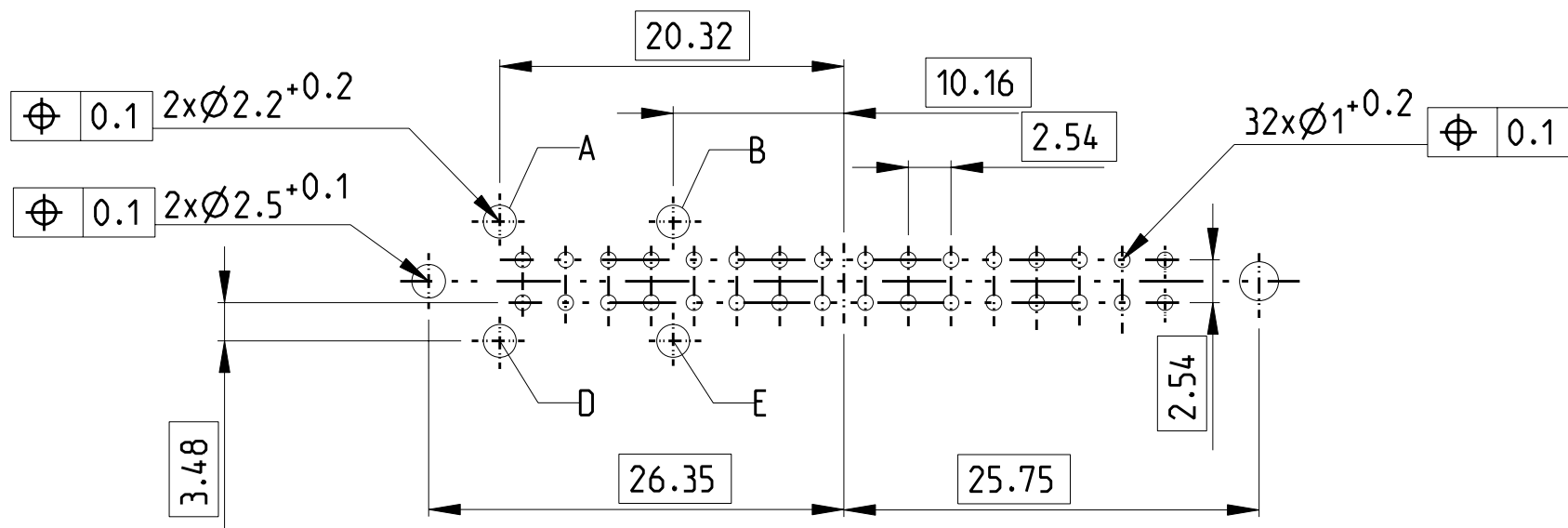


Einzelheit "Y"
M 5:1



Empfohlenes Leiterplatten Bohrbild

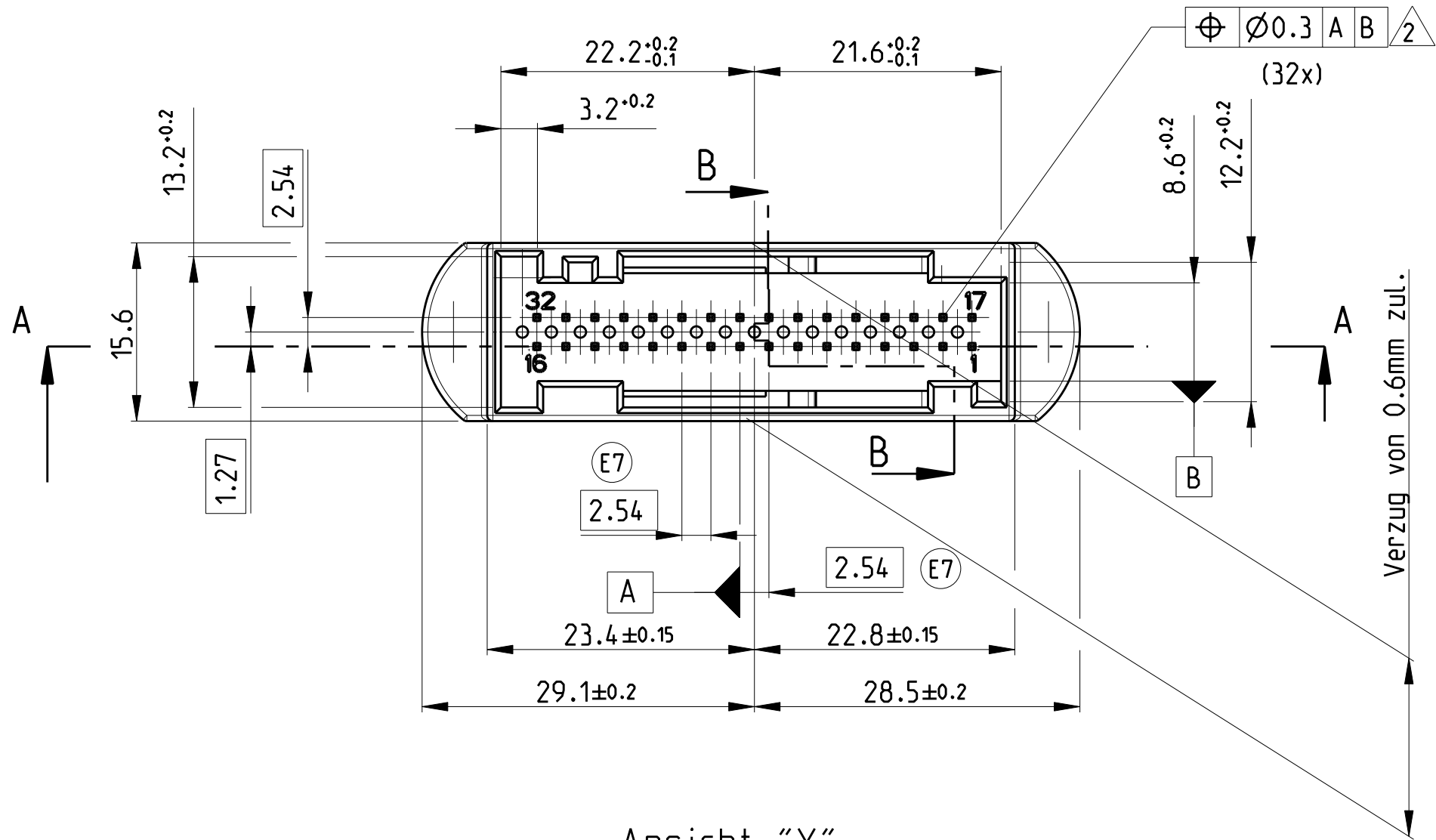
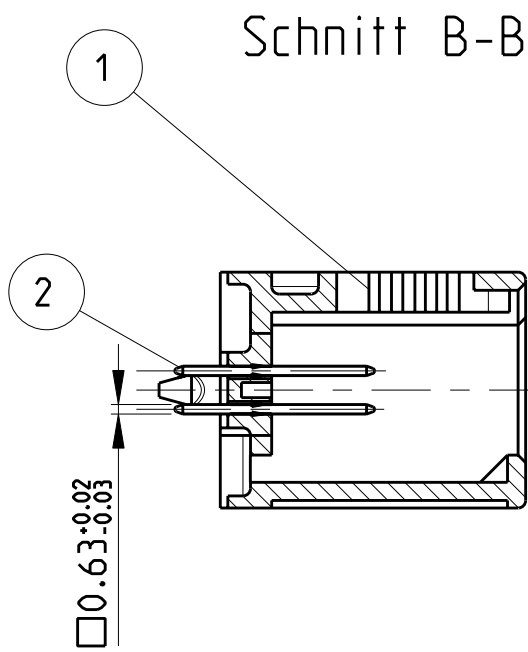


Bemerkungen:

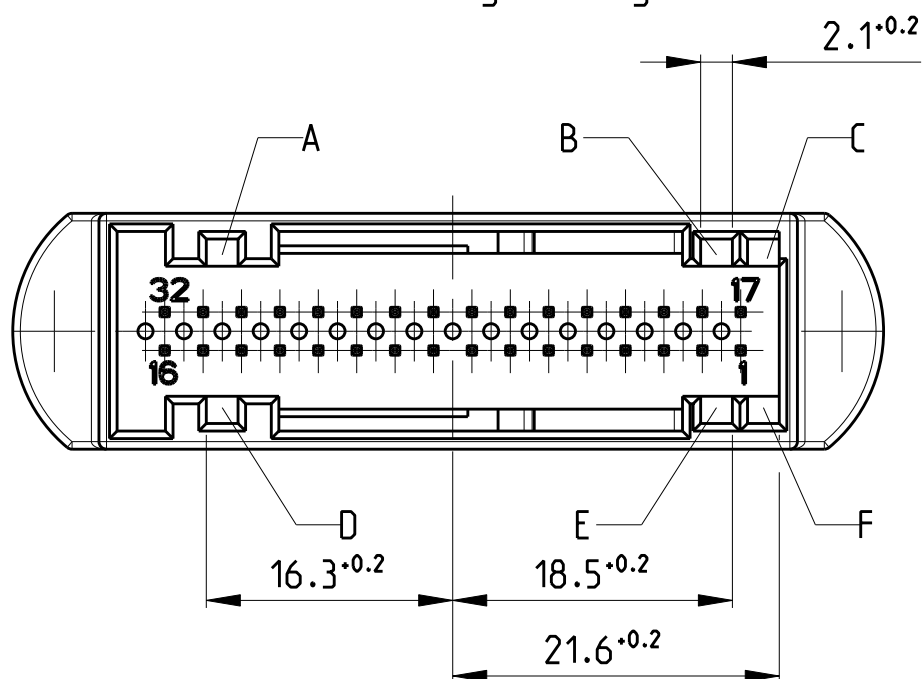
- 1 Ausführung der Leiterplattenkodierung und der Kodiernuten, siehe Tabelle
- 2 Form- und Lagetoleranz: "Position" gilt nur für die entsprechenden Spitzen
- 3 Einwegverpackung: Produktträger in Karton
- 4 Kontaktbereich min. 0,8 µm vergoldet
Lötlbereich min. 2,5 µm verzinkt
- 5 Mehrwegverpackung HELLA: Produktträger in Hella E1-Behälter MF 6320
- 6 Mehrwegverpackung Bosch: Produktträger in Bosch-Behälter 6000 515 033
- 7 Mehrwegverpackung VDO: Produktträger in VDO-Behälter MF 6170
- (E7) 8 Oberfl äche: 2,0 µm - 4,0 µm Sn über 1,27 µm - 2,2 µm Ni /galv. verzinkt, matt

NOTES:

- 1 THE EXECUTION OF THE PRINTED CIRCUIT BOARD CODING AND THE CODING SLOTS. SEE TABLE
- 2 FORM- AND POSITION TOLERANCE; "POSITION" IS VALID ONLY FOR THE APPROPRIATED POINTS
- 3 ONE-WAY PACKAGING: PRODUCT CARRIER IN CARDBOXn
- 4 KONTAKT AREA min. 0.8 μ m GOLD PLATED
SOLDER AREA MIN. 2.5 μ m TIN PLATED
- 5 MULTIPLE PACKAGING HELLA: PRODUCT CARRIER IN HELLA E1-BOX MF 6320
- 6 MULTIPLE PACKAGING BOSCH: PRODUCT CARRIER IN BOSCH-BOX 6000 515 033
- 7 MULTIPLE PACKAGING VDO: PRODUCT CARRIER IN VDO-BOX MF 6170
- 8 SURFACE: 2.0 μ m - 4.0 μ m SN OVER 1.27 μ m - 2.2 μ m NI /ELECTRO PLATED. MAT



Ansicht "X"
alle Kodierungen dargestellt

[illegible]